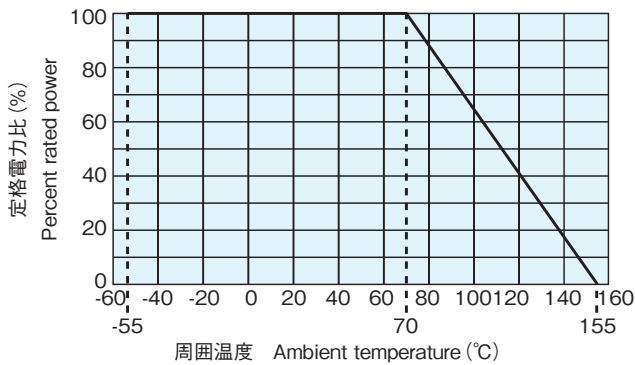
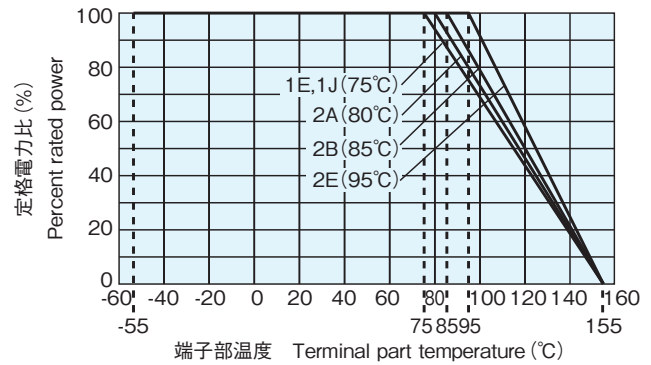


■負荷軽減曲線 Derating Curve



周囲温度70℃以上で使用される場合は、上図負荷軽減曲線に従って、定格電力を軽減して御使用ください。

For resistors operated at an ambient temperature of 70°C or above, a power rating shall be derated in accordance with the above derating curve.



上記の端子部温度以上で使用される場合は、負荷軽減曲線に従って定格電力を軽減してご使用ください。

※ご使用方法につきましては巻頭の“端子部温度の負荷軽減曲線の紹介”を参照願います。

For resistors operated terminal part temperature of described for each size or above, a power rating shall be derated in accordance with derating curve.
※Please refer to “Introduction of the derating curves based on the terminal part temperature” on the beginning of our catalog before use.

■性能 Performance

試験項目 Test Items	規格値 Performance Requirements $\Delta R \pm (\% + 0.05\Omega)$		試験方法 Test Methods
	保証値 Limit	代表値 Typical	
抵抗値 Resistance	規定の許容差内 Within specified tolerance	—	25°C
抵抗温度係数 T.C.R.	規定値内 Within specified T.C.R.	—	+25°C/+125°C : T.C.R. = $\pm 5 (\times 10^{-6}/K)$ +25°C/−55°C and +25°C/+125°C : another
過負荷 (短時間) Overload (Short time)	一般 General : 0.1 高電力 High Power : 0.5	0.01 0.03	定格電圧×2.5倍又は最高過負荷電圧の低い方を5秒印加 Rated voltage×2.5 or Max. overload vol., whichever is less, for 5s
はんだ耐熱性 Resistance to soldering heat	0.1	0.04	260°C±5°C, 10s±1s
温度急変 Rapid change of temperature	0.25	0.03	−55°C (30min.)/+125°C (30min.) 300 cycles
耐湿負荷 Moisture resistance	一般 General : 0.5 高電力 High Power : 0.5	0.06 0.07	40°C±2°C, 90%~95%RH, 1000h 1.5時間 ON/0.5時間 OFFの周期 1.5h ON/0.5h OFF cycle
70°Cでの耐久性 Endurance at 70°C	一般 General : 0.25 高電力 High Power : 0.5	0.02 0.1	70°C±2°C, 1000h 1.5時間 ON/0.5時間 OFFの周期 1.5h ON/0.5h OFF cycle
高温放置 High temperature exposure	0.25 0.5	0.1 0.25	+125°C, 1000h +155°C, 1000h

■使用上の注意 Precautions for Use

- 部品のテーピング材料は適正な静電気対策を施した物を使用しておりますが、実装に際して過度な乾燥状況である場合や、テーピング包装のまま長時間振動を加えた後にはトップテープに製品が静電気吸着し、搭載不良を起したり、部品が静電気(人体モデル100pF 1.5kΩにて、1J、2A、2B、2E:1kV以上 1E:0.5kV以上に相当)で破壊され抵抗値変化を起こす危険がありますのでご注意ください。基板実装時におきましても、同様に過度な静電気が印加されませんようご注意ください。
- 本製品及び実装したプリント基板にフラックスや人の汗や唾液等に含まれるイオン性不純物質が付着しておりますと、耐湿性・耐腐食性等の点から好ましくありません。フラックス内には塩素や酸、人の汗及び唾液にはナトリウムイオン(Na⁺)、塩素イオン(Cl⁻)等が含まれておりますので、製品がそれらに汚染されると電蝕が誘発される事が確認されております。特に鉛フリーはんだを御使用の場合、濡れ性向上の為、イオン性物質を多く含有している事がありますので、RMA系のはんだ又はフラックスを御使用になるか、十分な洗浄を行ってください。また、防湿コート材を塗布される場合、製品と防湿コート間に上記汚染物が残存しますと、更に電蝕を誘発する事が確認されておりますので、防湿コート材塗布前に洗浄されることをお勧めいたします。
- 実装時、チップ抵抗器に耐熱用マスキングテープを貼り付け、剥がしますと上面電極が剥離することがあります。特に実装時の熱によりテープの粘着剤の接着強度も高まる事が確認されておりますので、ご使用を控えていただくか、使用される場合は、テープ粘着剤が直接製品に触れない方法にてご対応いただけます様にご配慮ください。
また、高圧のシャワー洗浄を行いますと、水圧のストレスにより、上面電極が剥離することがありますので、ご使用を控えていただくか、使用される場合は、事前に評価の上、ご使用ください。
- The properly and electrostatically measured taping materials are used for the components, but attention should be paid to the fact that there is some danger the parts absorb on the top tapes to cause a failure in the mounting and the parts are destructed by static electricity (1kV and more : 1J, 2A, 2B, 2E 0.5kV and more : 1E, Human Body Model 100pF 1.5kΩ) to change the resistance in the conditions of an excessive dryness or after the parts are given vibration for a long time as they are packaged on the tapes. Similarly, care should be given not to apply the excessive static electricity when mounting on the boards.
- Ionic impurities such as flux etc. that are attached to these products or those mounted onto a PCB, negatively affect their moisture resistance, corrosion resistance, etc. The flux may contain ionic substances like chlorine, acid, etc. while perspiration and saliva include ionic impurities like sodium (Na⁺), chlorine (Cl⁻) etc. Therefore these kinds of ionic substances may induce electrical corrosion when they invade into the products. Either thorough washing or using RMA solder and flux are necessary since lead free solder contains ionic substances. Washing process is needed, before putting on moisture proof material in order to prevent electrical corrosion.
- When heat-resistant masking tapes are attached to the chip resistors at the time of mounting and then detached, there is a possibility of exfoliation of the top electrodes. It is known that the heat applied in the mounting process will enhance the adhesion strength of the tape adhesive so please avoid the use. If the use of masking tapes are unavoidable, then please be sure not to attach the tape adhesives directly on the products.
When high-pressure shower cleaning is implemented, there is a possibility of exfoliation of the top electrodes caused by the water pressure stress so please avoid the implementation.
If the implementation is unavoidable, then please evaluate the products beforehand.